



Feature 特点

- 无卤素 T_g(DMA) 220°C 极低损耗产品
- 优良耐热性能
- 优良通孔可靠性
- 优良耐CAF性能
- Halogen-free T_g(DMA) 220°C High Speed Ultra Low Loss Product
- Excellent Thermal Resistance
- Excellent PTH Reliability
- Excellent Anti-CAF Performance

Application 应用

- 交换机、服务器、路由器、通讯设备、汽车等
- Switch、Server、Router、Communication Equipment、Automotive etc.

Feature 特点

Base Color 基板颜色	Thickness 厚度	Copper Thickness 铜箔厚度	Regular Size 常规尺寸
Yellow 黄色	0.03~4.0 mm	Toz~4oz	2082*1245m (82*49) 1092*1245mm (43*49) 2184*1245m (86*49)

Note: Other sheet size and thickness could be available upon request.
可根据客户要求提供其他尺寸和厚度

General Properties 一般特性

测试项目 Test Item	单位 Unit	测试方法 Test Condition (IPC-TM-650)	处理条件 Treatment Condition	规格值 Specification	典型值 Typical Value	
玻璃态转化温度 T _g (DMA)	°C	2.4.25	E-2/105	≥170	220	
剥离强度 (HVLP 35um) Peel Strength	N/mm	2.4.8	热应力后 (Float 288°C/10sec)	/	0.5	
热应力 (288°C) Thermal Stress	Cycle	2.4.13.1	未蚀刻	≥60	>400	
介电常数 (RC50%) Permittivity	10GHZ	-	2.5.5.13	C24/23/50	≤4.2	3.8
介质损耗 (RC50%) Loss Tangent	10GHZ	-	2.5.5.13	C24/23/50	≤0.015	0.0035
体积电阻率 Volume Resistivity	MΩ-cm	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1X10 ⁶	5.0x10 ⁸	
表面电阻率 Surface Resistivity	MΩ	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1X10 ⁴	4.0x10 ⁷	
电气强度 Electric Strength	KV/mm	2.5.6.2	D-48/50+ D-0.5/23	≥30	50	
耐电弧性 Arc Resistance	SEC	2.5.1	D-48/50+ D-0.5/23	≥60	180	
击穿电压 Dielectric Breakdown	KV	2.5.6	D-48/50+D-0.5/23	≥40	55	
弯曲强度 Flexural Strength	LW经向	2.4.4	常态A	≥415	550	
	CW纬向			≥345	460	
吸水率 Water Absorption	%	2.6.2.1	D-24/23	≤0.5	0.1	
Z轴膨胀系数 CTE Z-Axis	Before T _g , TMA	2.4.24	E-2/105	≤60	60	
	After T _g , TMA			≤300	190	
	50~260°C			≤3.0	1.9	
热分层时间 Thermal stratification	T260	2.4.24.1	蚀刻, E-2/105	≥30	>60	
	T288去铜			≥5	>60	
热分解温度 Td	Weight Loss 5%	2.4.24.6	E-2/110	≥340	425	
燃烧性E Flammability	Rating	UL94	E-24/125+DES	V-0	V-0	
相对漏电起痕指数 CTI	-	IEC-60112	常态A	PLC 3	PLC 3	

Specification sheet: IPC-4101/130, for reference only.